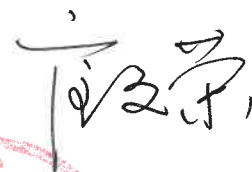


验收情况真实性、涉密性声明

我单位声明：此次半导体分立器件芯片材料制造项目（一阶段）竣工环境保护验收事项，所公示材料均真实、合法。根据《建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）》的有关规定，验收监测（调查）报告全本中原辅材料、生产设备、工艺流程等涉及商业秘密，不作为公示材料（纸质文本中没有隐去）其余内容不含涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私以及涉及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定的内容，可以公开。如有不实之处，愿负相应的责任，并承担由此产生的后果。

特此声明！

单位法人代表（签字）



单位（盖章）



2019 年 10 月 26 日